

惠州光弘科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

根据公司发展战略，为推进公司打造成全球领先 EMS 企业的战略布局，提升公司综合竞争力，2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》。公司拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 All Circuits S.A.S.（以下简称“AC 公司”）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称“TIS 工厂”）0.003%股权。收购完成后，公司将控制 AC 公司及其控股的 TIS 工厂的 100%股权，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。

经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。

公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-043），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

二、本次交易进展

公司已于 2024 年 12 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-050），对本次交易进展情况进行了说明。

公司的控股子公司 ALL CIRCUITS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.已在 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权转让项目公开挂牌期间，向北京产权交易所递交了受让申请。2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，公司已按受让资格确认通知书要求，在规定时间内

向北京产权交易所指定的结算账户支付了保证金 7,329.45 万元人民币等值的美
元 1,019.25 万元，获得了受让资格确认。

截至本公告披露之日，标的公司的审计、评估工作正在进行中。鉴于标的公
司位于境外，涉及的审计、评估等相关工作程序相对复杂，预计尚需一定时间完
成，交易双方尚未签署产权交易协议，公司及相关各方正在积极推进本次交易的
相关工作，后续公司亦将按照相关法律法规的规定及时披露项目进展情况。

三、风险提示

本次交易双方尚需就本次交易方案进行论证和协商，签署产权交易协议等文
件，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日